

PALTEK

(証券コード:7587)

2018年12月期 決算説明資料

2019.2.28 (木)

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

本資料取り扱い上の注意点

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合

- ① 2018年12月期 業績結果
- ② 2019年12月期 業績予想
- ③ 今後に向けた取り組み
- ④ 中期経営計画について

1

2018年12月期 業績結果

2018年12月期 業績結果 サマリ

- 市場環境は自動車関連の産業機器は堅調だが、通信インフラは低調に推移
- 売上高および各利益は、前期から減少
 - 通信市場、海外情報端末向けの低迷、アナログ半導体メーカーとの契約解消が影響
 - 主要仕入先での取引形態変更により、利益率が低下
- 新たな取り組みを加速
 - AIソリューションの新規立ち上げ

(百万円)	2017年12月期		2018年12月期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
売上高	33,075	100.0%	30,569	100.0%	△2,506	△7.6%
売上総利益	4,275	12.9%	3,700	12.1%	△574	△13.4%
販管費	3,237	9.8%	3,142	10.3%	△95	△2.9%
営業利益	1,037	3.1%	558	1.8%	△478	△46.2%
経常利益	1,084	3.3%	299	1.0%	△785	△72.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	703	2.1%	185	0.6%	△517	△73.6%
1株当たり当期純利益	64.18円	-	16.97円	-	△47.21円	△73.6%

主な増減要因

- 売上高の減少は、半導体事業の減少による
- 売上総利益の減少は、売上高の減少および主要仕入れ先との取引形態変更による売上総利益率の低下による
- 経常利益の減少は、主に営業利益の減少のほか為替差損の発生による

(百万円)	2017年12月期		2018年12月期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
半 導 体	31,334	94.8%	28,536	93.3%	△2,797	△8.9%
デザインサービス	1,530	4.6%	1,799	5.9%	269	17.6%
ソリューション	211	0.6%	233	0.8%	22	10.5%
売上高合計	33,075	100.0%	30,569	100.0%	△2,506	△7.6%

主な増減要因

- 半導体事業は、通信市場、海外情報端末向けの低迷、アナログ半導体メーカーとの契約解消によりアナログ半導体が減少
- デザインサービス事業は、医療機器、通信機器向けが増加
- ソリューション事業は、医療機関向け停電対策システムが減少したものの、乳幼児呼吸見守りシステム、IoTゲートウェイが増加

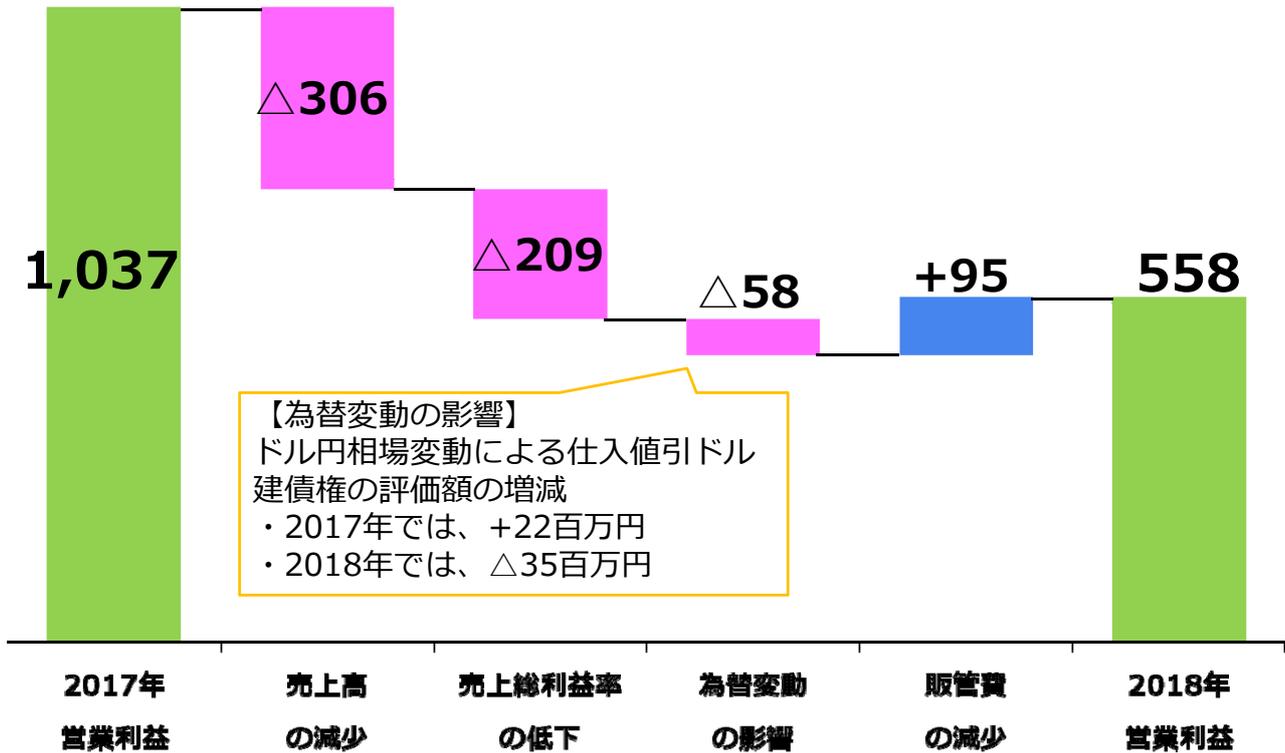
■ 売上総利益率の減少は、以下の2つが要因

- 主要仕入先であるザイリンクス社との取引形態変更により、主要大手顧客に対してはプロモーション活動を行わず、販売・オペレーション業務のみを実施。そのため、売上総利益率が低下
- ドル円相場により変動する仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額の増減等により売上総利益が、
2017年では +22百万円 (+0.1%分)
2018年では △35百万円 (△0.1%分) の影響があったこと

(百万円)	2017年12月期		2018年12月期	
	金額	対売上比率	金額	対売上比率
売上総利益	4,275	12.9%	3,700	12.1%
(うち為替の影響額)	+22	+0.1%	△35	△0.1%
売上総利益 (為替の影響を排除)	4,252	12.9%	3,736	12.2%

営業利益の増減分析

(単位：百万円)

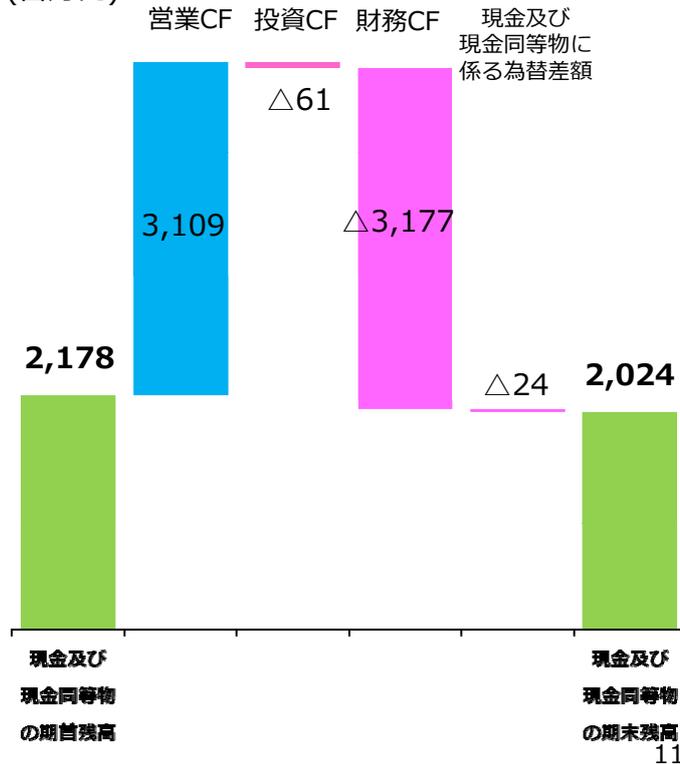


連結貸借対照表の状況

	(百万円)	2017.12	2018.12	増減額	主な増減理由
資産内訳	現金及び預金	2,178	2,024	△154	
	売上債権	7,087	6,354	△733	
	商品	3,559	3,126	△433	
	その他流動資産	3,904	1,844	△2,059	未収入金が減少
	固定資産	450	497	47	
資産合計		17,180	13,846	△3,333	
負債純資産内訳	仕入債務	1,387	945	△441	
	短期借入金	5,030	2,010	△3,020	借入金を返済
	その他流動負債	999	1,091	91	
	固定負債	261	256	△4	
	純資産	9,501	9,542	41	
負債・純資産合計		17,180	13,846	△3,333	

連結キャッシュ・フローの状況

2018年12月期のキャッシュフローの動き
(百万円)



(百万円)	2017年 12月期	2018年 12月期
現金及び現金同等物の期首残高	2,698	2,178
営業CF	△1,933	3,109
投資CF	△61	△61
財務CF	1,358	△3,177
現金及び現金同等物の期末残高	2,178	2,024

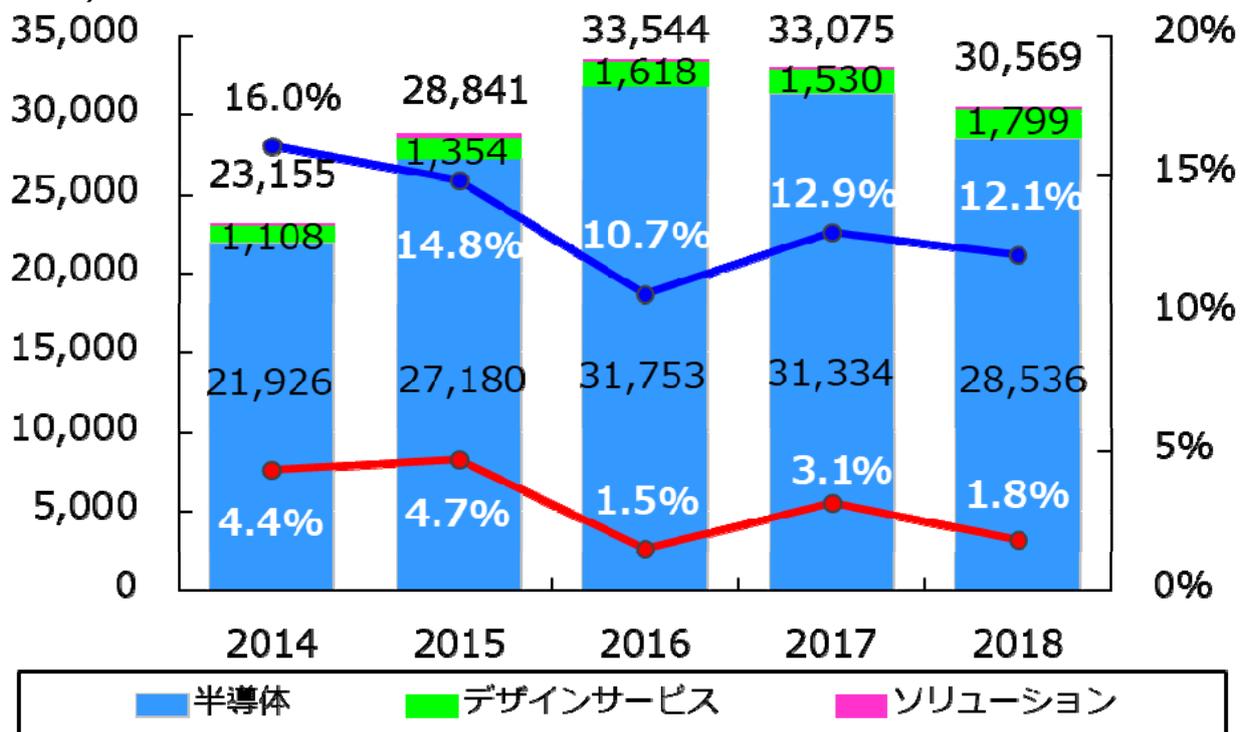
2018年12月期のキャッシュフローの動き

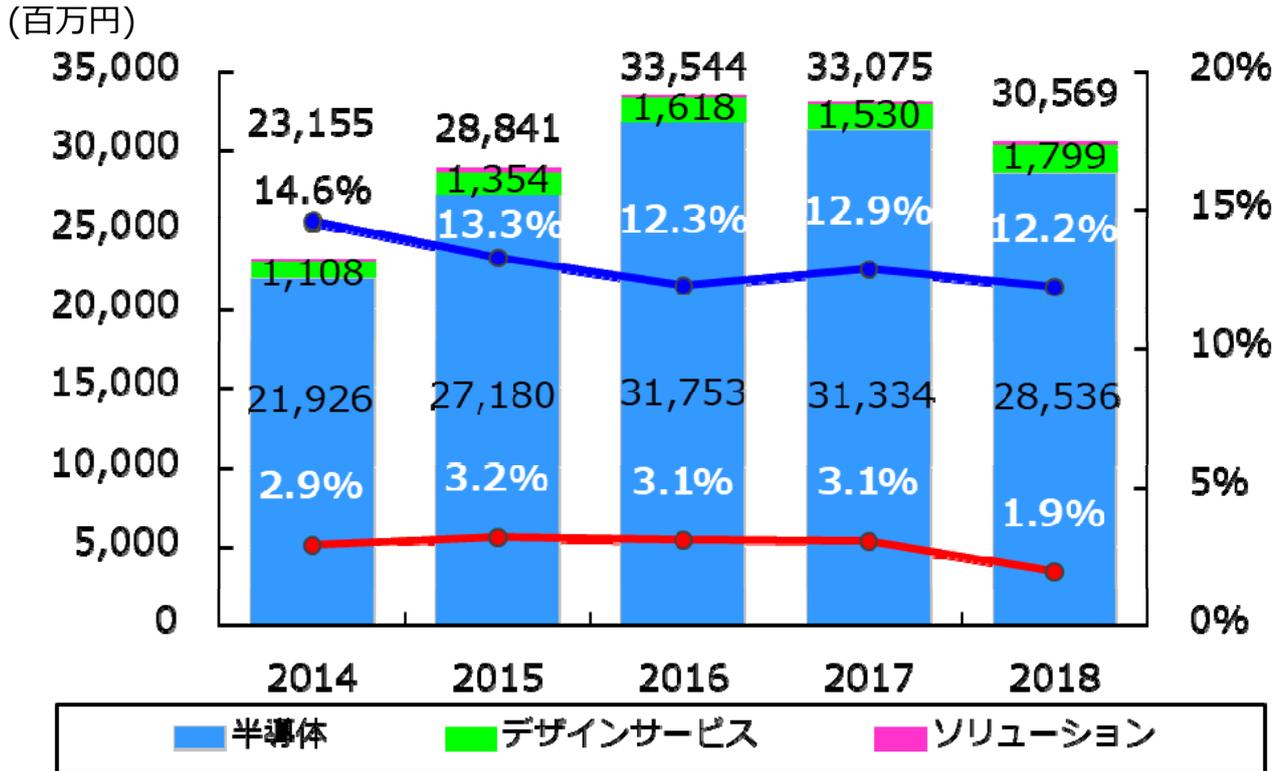
- 【営業CF】 税金等調整前当期純利益の計上したこと、未収入金の減少等により収入
- 【投資CF】 投資有価証券、子会社株式を取得したこと等により支出
- 【財務CF】 配当金支払いを実施したこと、借入れの返済等により支出

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.

連結業績推移

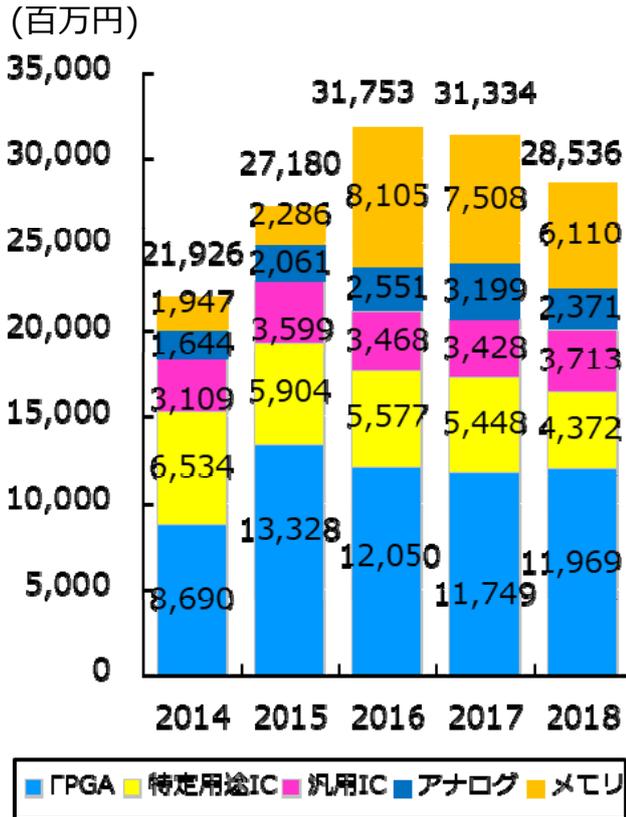
(百万円)





事業別の実績

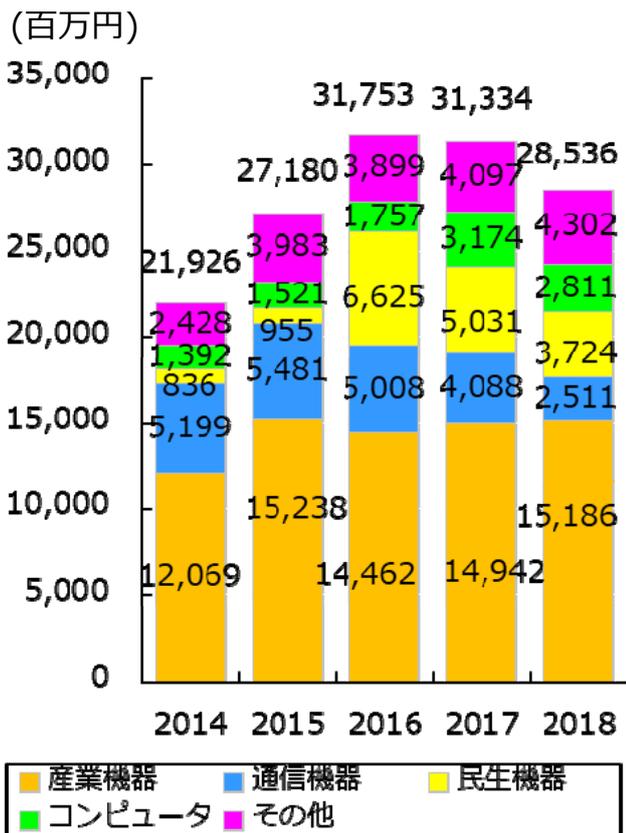
半導体事業の状況 (製品別)



業績の推移

- FPGA**
ファクトリーオートメーション、医療機器向けなどが増加
- 特定用途IC**
通信機器向けが減少
- 汎用IC**
ファクトリーオートメーション向けなどが増加
- アナログ**
アナログ半導体メーカーとの取引終了のため減少
- メモリ**
海外メーカー向けが減少

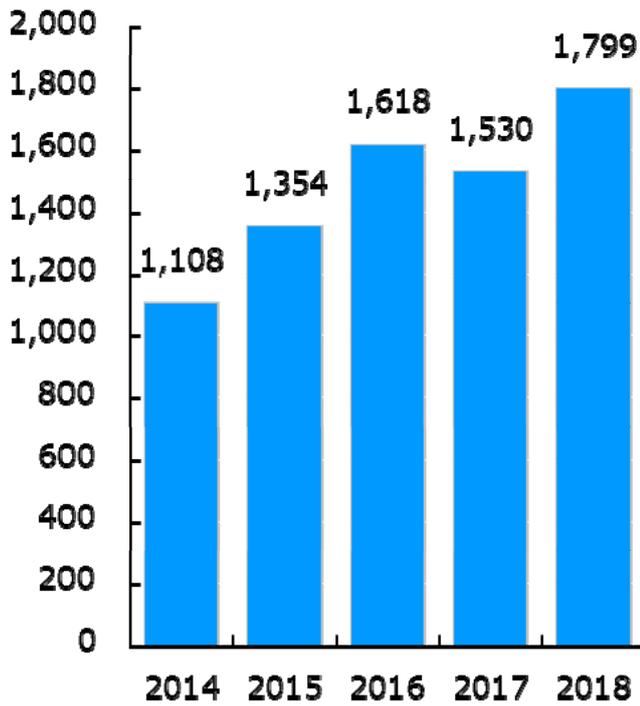
半導体事業の状況 (用途別)



業績の推移

- 産業機器**
ファクトリーオートメーション向けなどが増加
- 通信機器**
通信インフラ、ブロードバンド通信向けが減少
- 民生機器**
海外メーカー向けが減少
- コンピュータ**
スーパーコンピュータ向けが減少

(百万円)



業績の推移

- 通信機器、医療機器向けの案件が増加
- ODMの比率は60%

2

2019年12月期 業績予想

■ エレクトロニクス業界と取り巻く事業環境

- ・ 米中貿易摩擦の影響で先行きは不透明に
- ・ 各国の経済成長率が鈍化傾向

■ 主要仕入先ザイリンクス社との取引形態変更の影響

- ・ 取引形態変更の影響による利益率低下は、今年度から1年を通しての影響となるため、昨年に比べ半導体事業での利益の減少要因となる

■ 将来に向けた新たな取り組みによる先行投資を継続

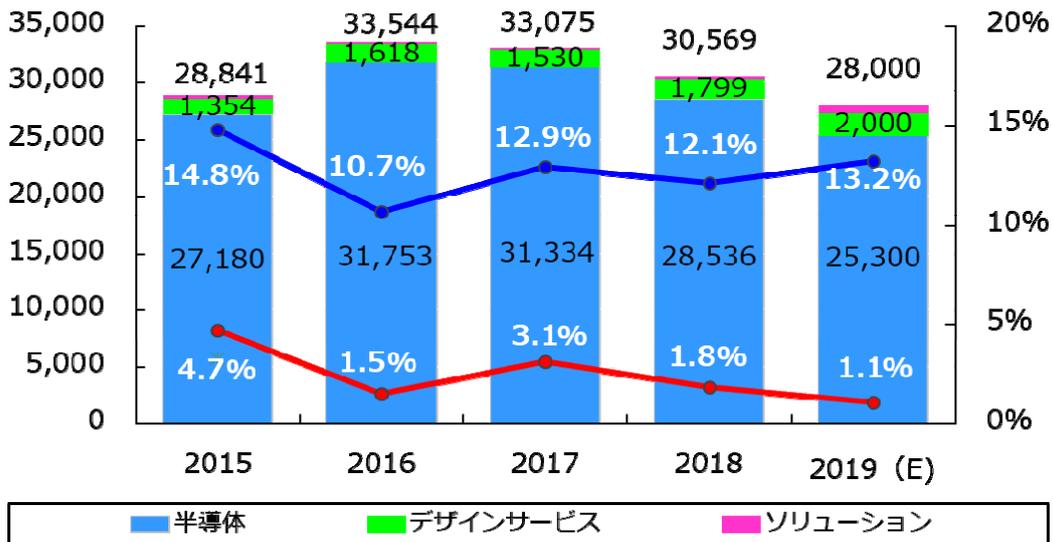
- ・ モデルベース開発（MBD）による受託開発の着手
 - 自動車市場に参入するため、MBDによる受託開発ができる体制整備
 - 今後の2年は先行投資期間

■ 為替の影響を反映

- ・ 開示時点において、ドル円相場は円高方向に進行しているため、第1四半期に売上総利益に対して1億円のマイナス影響を見込む

(百万円)	2018年12月期 実績			2019年12月期 予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
売上高	15,585	14,984	30,569	13,000	15,000	28,000	△2,569	△8.4%
売上総利益	1,931	1,769	3,700	1,700	2,000	3,700	0	0.0%
売上総利益率	12.4%	11.8%	12.1%	13.1%	13.3%	13.2%	-	-
販管費	1,549	1,592	3,142	1,670	1,730	3,400	257	8.2%
営業利益	381	176	558	30	270	300	△258	△46.3%
営業利益率	2.4%	1.2%	1.8%	0.2%	1.8%	1.1%	-	-
経常利益	227	71	299	30	220	250	△49	△16.4%
当期純利益	133	52	185	20	150	170	△15	△8.5%

(百万円)



- 売上高 : デザインサービス事業、ソリューション事業は増加するものの、半導体事業が減少
- 売上総利益率 : FPGAの利益率が低下するものの、利益率の低い半導体製品の売上高が減少すること、利益率の高いデザインサービス事業・ソリューション事業の売上高が増加するため上昇
- 営業利益率 : MBD、AIソリューションなどの新規事業への人材投資を継続するため販売費及び一般管理費が増加し、営業利益率は低下

株主還元方針および1株当たり配当金

- 利益配分については、経営基盤の強化や将来の事業展開を考慮し、適正に配分。株主の皆様へは、配当金にて還元いたします
- 配当金については、安定的な配当を維持しながら、業績に対する配当性向を勘案
- 2019年12月期配当金は、1株あたり10円を予定

配当金の推移

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年(予)
1株当たり配当金	8円	8円	15円(※)	13円	13円	10円	10円
配当性向(連結)	20.6%	16.2%	24.4%	1,238.7%	20.3%	58.9%	64.4%
当期純利益(百万円)	443	563	674	11	703	185	170

※ 普通配 : 12円、記念配 : 3円

■ 対象となる株主様

- 毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された100株以上を保有している株主様

■ 株主優待の内容

- 毎年12月31日現在の保有株式数と継続保有期間に応じて、優待品（クオカード）を年1回贈呈



保有株式数	継続保有期間	
	3年未満	3年以上
100株以上～500株未満	クオカード500円分	クオカード1,000円分
500株以上～1,000株未満	クオカード1,000円分	クオカード2,000円分
1,000株以上	クオカード2,000円分	クオカード3,000円分

3

今後に向けた取り組み



PALTEKの方向性

■ 各事業の方向性

ソリューション事業【新規】

既存事業を活用し、市場ニーズに合ったソリューションを提供する事業

デザインサービス事業

半導体事業で積み重ねた強味を活かし、常に新しい技術を活用した開発力と設計品質の向上に努め、付加価値を高める事業

半導体事業

成長市場に注力し、安定的に収益を上げていく基盤事業



PALTEKグループの強み



半導体をベースにした営業力・提案力・開発力



無線通信技術



画像処理技術



制御技術



センサ技術

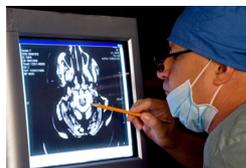


注力技術

AI、IoT、5G、ADAS、ビッグデータ、ロボット



産業機器



医療



放送・映像



交通インフラ



車載

【事業環境】

- **AI、ビッグデータ、IoTの活用により半導体市場が拡大**
 - さまざまなモノがインターネットに接続され、IoT関連やデータセンター向けの半導体市場が成長
- **車載分野およびその周辺市場は堅調**
 - 自動運転、電気自動車(EV)が更に発展

取り組み

- **AIソリューションの構築**
- **IoT、データセンター、車載周辺市場などの成長分野に提案力を強化**
(Xilinx、Micron、NXP、Microchip、MPS)

【FPGA市場動向】

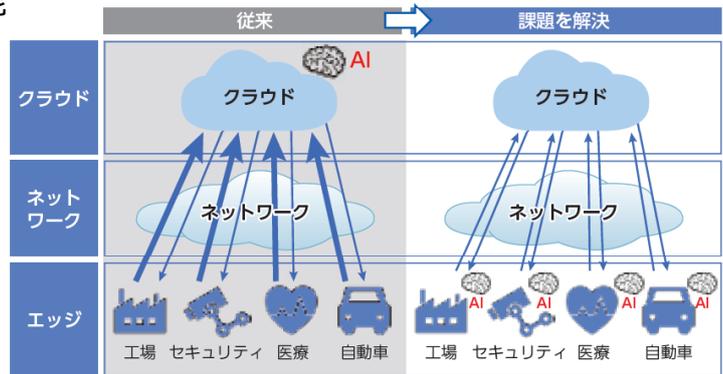
- **2017年～2023年まで年平均成長率7.8%で市場が拡大**
 - 特に、車載、防衛、データセンター&コンピューティング向けでは8%以上で成長
- **ザイリンクス社では、成長市場に合わせ新製品を随時投入**
 - AI搭載のACAP VERSAL™ AIコアシリーズを発表(2018/3)
5G, ネットワーキング, クラウドに最適
 - データセンター向けにAlveo™ アクセラレータ カードを発表(2018/10)
 - 防衛グレード16nm UltraScale+™ポートフォリオ提供(2018/11)

取り組み

- **AIソリューションの構築・展開**
- **車載向けのFPGA導入を促進するため、モデルベース開発による設計受託に着手**

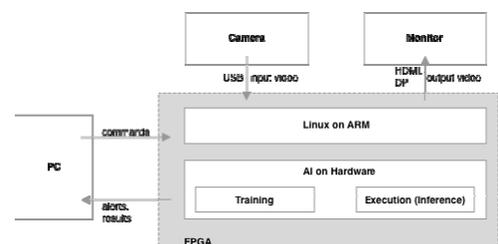
■ エッジ向けAIソリューションを開拓

- IoTにおいて、エッジコンピューティングへのニーズが高まる【3つの課題】
 - クラウドとの通信処理で遅延が発生
 - セキュリティ面でのリスク
 - インターネット環境が不安定だと処理停止
- エッジコンピューティングでのAI活用においては、FPGAが最適
 - システム環境の変化に柔軟に対応が可能
 - リアルタイム処理が可能
 - 低消費電力
 - 長期供給が可能



■ エッジ側での 画像処理 AI (in FPGA)

- ディープラーニング・ソリューション
 - AI FPGA モジュール「ZIA™ C3」を提供開始
 - 【用途】分類 / 検出 / セグメンテーション
一般的ディープラーニング技術を
小型 / 高速 / 低電力
- スパースモデリング・ソリューション
 - エッジ学習が可能なFPGA 向け AI ソリューション「HACARUS-X Edge」を提供開始
 - 【用途】特徴抽出 / 移動体検出
小さなアルゴリズムでディープラーニングと比べ、
学習量が少なく済む



■ 成長市場へ新規案件活動に注力

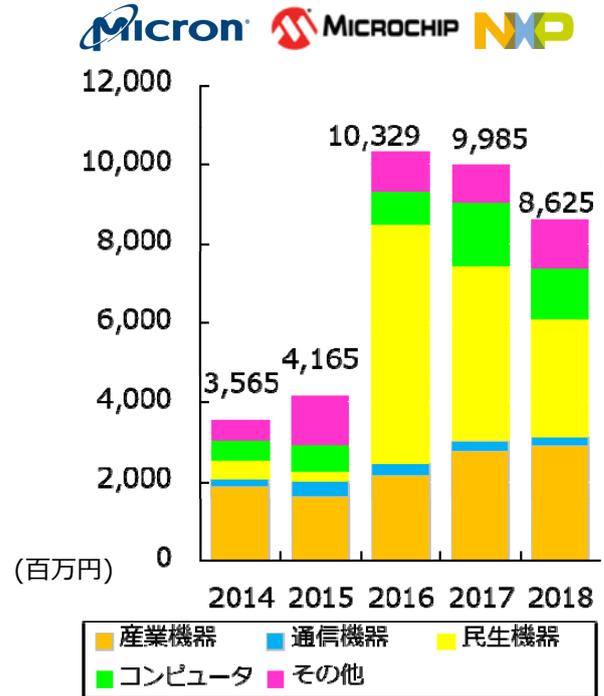
- ・ データセンター
- ・ AI / IoT
- ・ 産業機器
- ・ 医療機器

■ マルチ商材提案力

■ 営業効率化の強化

例 : FPGA + Memory + Power

主要3製品の売上推移



【事業環境】

- ・ 機器自体やそれを構成する半導体などが高機能化・高度化し、すべてをお客様のみで開発することが困難
- ・ お客様は社外リソースも活用し、製品リリースの早期化が必要



事業構成

- ・ 設計受託
- ・ ODM/EMS

取り組み

- ・ 営業力の強化 (ODM案件発掘に注力)
- ・ 開発人員の増強
- ・ AI、IoT開発案件の獲得
- ・ モデルベース開発体制の構築および設計受託スタート

■ 事業の状況

- 産業機器、医療機器が堅調

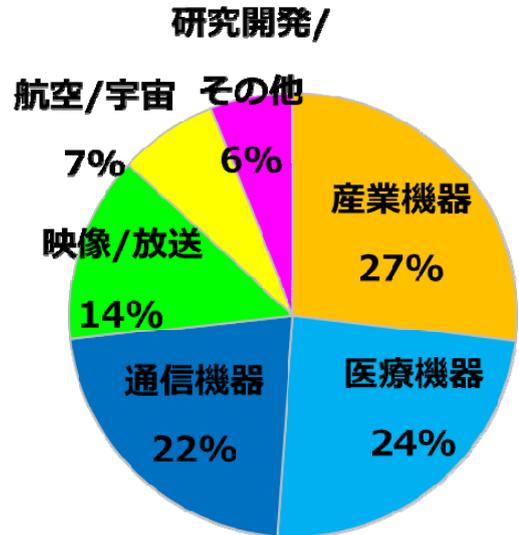
■ 設計受託・ODMの今後の展開

- AI、IoT、5Gなどの新技術を活用した案件獲得に注力

■ グループ会社での事業展開

- エクスプローラ
 - 受託・ODM・自社製品販売強化
- テクノロジーイノベーション
 - センサー開発・営業力強化
- ウィビコム
 - 受託開発継続獲得へ

用途別売上構成（2018年）



■ ODMビジネス

設計開発
受託

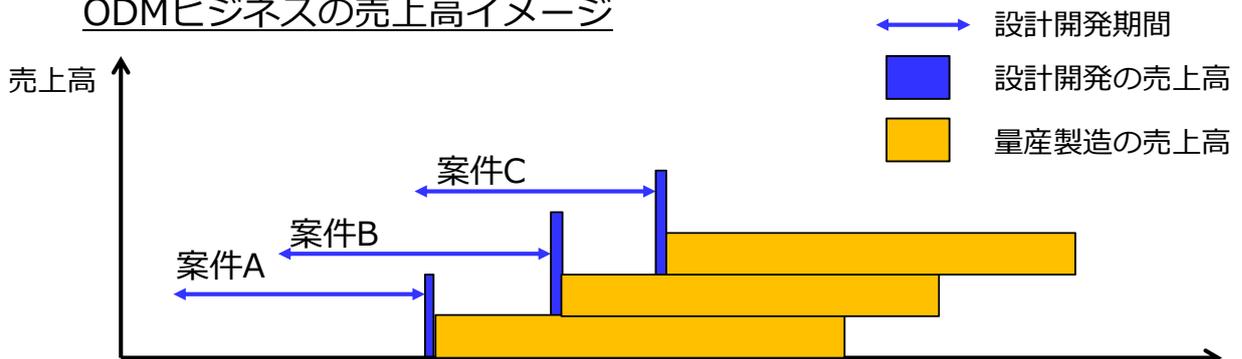
+

量産製造
受託

【お客様のメリット】

- PALTEKのFPGA技術力を活用し、開発期間を短縮・開発費を低減
- 仕様検討から量産まで一貫した対応で、顧客の負荷を低減

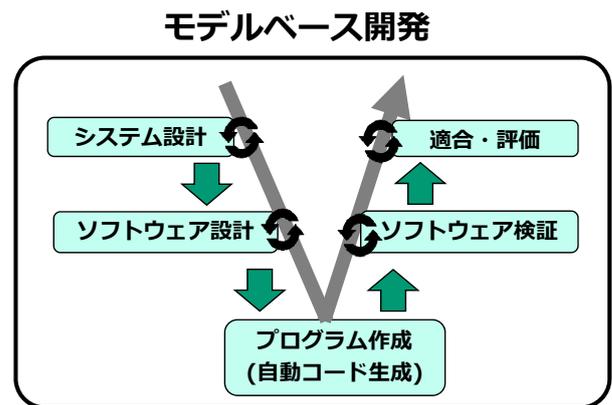
ODMビジネスの売上高イメージ



- モデルベース開発（MBD : Model Base Design）の車載分野向けでの受託事業を開始
- FPGAのノウハウを、新たに車載分野に活用（MBD → FPGA(ハードウェア化)）

■ 今後の取り組み

- 2019年度
 - 技術者の育成/人員確保
 - 2019年度中に受託開発開始
- 2020年度
 - 本格的に受託開発を促進



■ ソリューション事業の狙い

- 市場拡大が見込まれる分野に注力したソリューションを発掘・開発
- 将来的にIoTやサービス等の付加価値の可能性のあるソリューションを展開

	産業	映像・放送	医療・介護 ヘルスケア	自動車	物流
既存顧客	工場向け監視システム	映像配信システム	乳幼児呼吸見守りセンサー ウェアラブルロボット	TPMS 運行管理システム	紙梱包ソリューション
新規顧客					

要素技術は、通信、画像処理、センシング

■ ビジネスの位置づけ

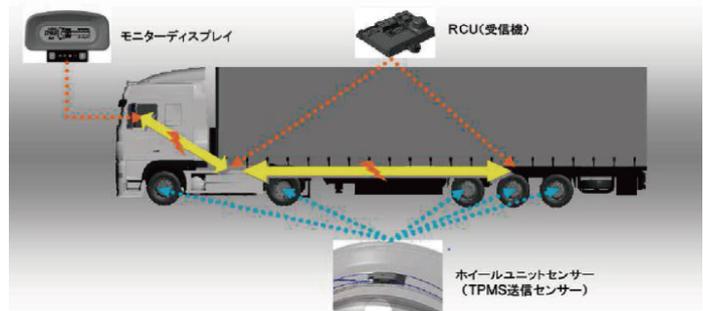
- 通信技術の活用により新たに自動車分野へ参入
- サービス展開も視野にビジネス展開

■ ビジネスの進捗状況

- 運送会社、バス会社への事業展開

■ 今後の展開

- トラックメーカーへのアプローチを開始
 - ビジネスの立ち上げには時間がかかるが、メーカーへのアプローチにチャレンジ



■ ビジネスの位置づけ

- 成長すると見込まれる物流分野への事業展開
- 生態系への影響懸念により脱プラスチックが進む中、プラスチック系緩衝材に代わる紙緩衝材活用による物流コスト低減提案
- ストック型ビジネス

■ 展示会、問い合わせのフォロー継続により案件化

■ 今後も展示会等への出展により認知を促進し、製品トライアルへ



■ ビジネスの進捗状況 (2018年12月末)

- トライアル : 46社 (2018年9月末から27社増)
73台 (2018年9月末から44台増)
- 採用 (累計) : 22社 (2018年9月末から13社増)
100台 (2018年9月末から40台増)

- 不安定な伝送路でも映像データを伝送できる秘匿性の高い4K対応 H.265/HEVCコーデックシステムを開発

【特長】 高画質、低遅延、セキュアな画像伝送を実現



【SRTプロトコルについて】

SRTプロトコルはHaivision社が開発し、2017年4月にオープンソース化された、不安定なネットワーク環境に強く、高品質のまま映像を伝送できる次世代の伝送規格。

SRT普及を推進するSRTアライアンスには、Microsoft社なども加盟。



- 欧州最大の放送機器展「IBC 2018」に出展

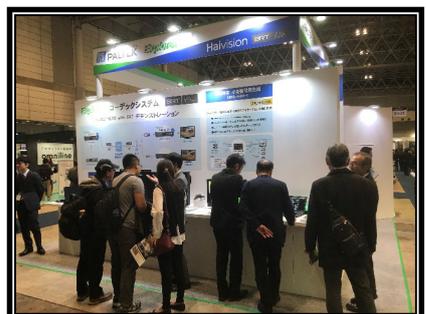
- ・ 開催日 : 2018年9月14日 (金) ~18日 (火)
- ・ 開催国 : オランダ アムステルダム



- 国内の放送機器展「Inter BEE 2018」に出展

- ・ 開催日 : 2018年11月14日 (水) ~16日 (金)

- SRT搭載 4K対応H.265/HEVCコーデックシステムなどを展示し、国内外でのプロモーションを加速



4

中期経営計画について

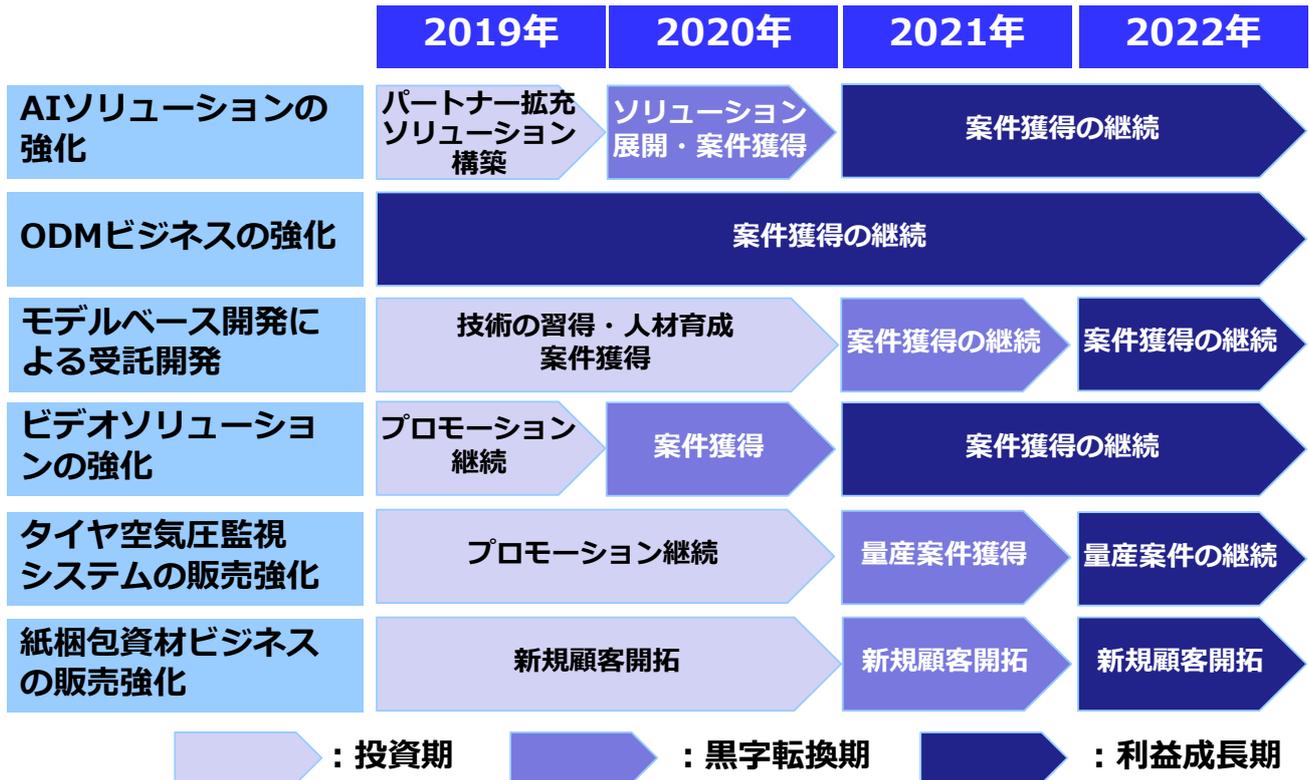
中期経営計画の達成時期の変更

■ 中期経営計画の達成時期の変更

- 当初計画：2020年度に売上高400億円以上、営業利益率5%以上
- 達成時期を「2020年度」から「2022年度」に変更

■ 変更の理由

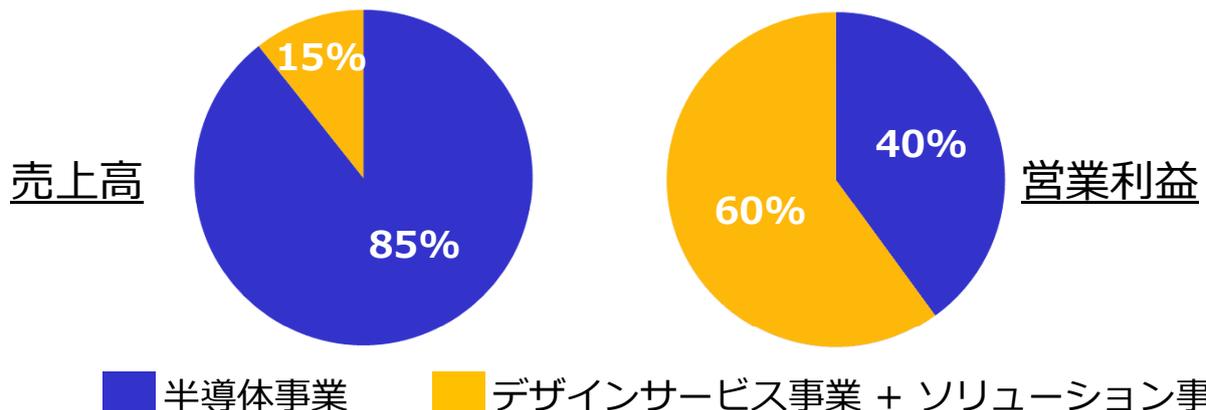
- ザイリンクス社との取引形態変更により利益率が低下
- その対策として中期的に収益向上を見込める事業体制を構築中
 - 半導体事業：AIソリューションビジネス立ち上げ
 - デザインサービス事業：ODMビジネスの強化、MBDビジネス立ち上げ
 - ソリューション事業：ビデオソリューション、TPMSビジネス、紙梱包資材ビジネスなどの立ち上げ
- これらの事業の立ち上げには投資と時間が必要



■ 数値目標 (2022年度)

売上高	400億円以上
営業利益率	5%以上

2022年時の売上高/営業利益の構成イメージ



参 考 資 料

© 2019 PALTEK Corporation. All rights reserved.



為替変動に関する影響

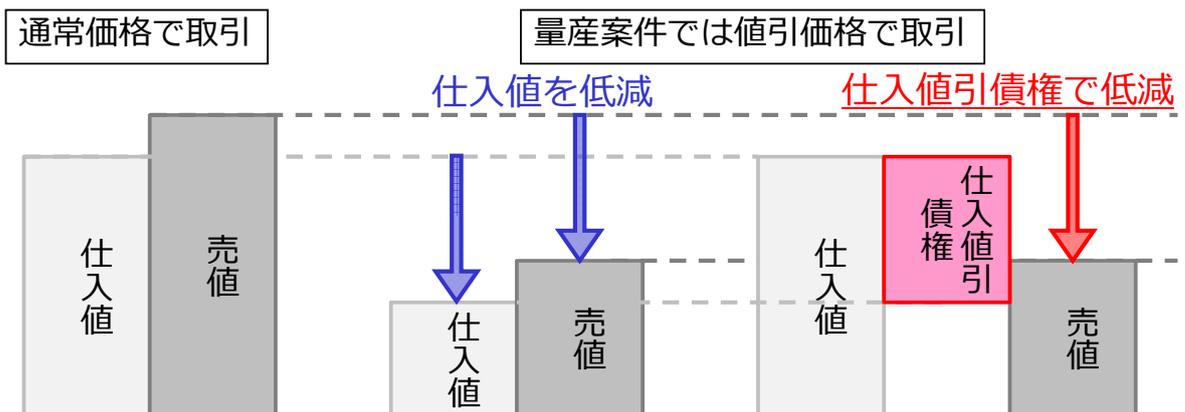
- 為替変動により当社グループの利益は以下の4点で影響を受けます

- ① 仕入値引ドル建債権の為替変動による影響
- ② 調達在庫の為替変動による影響
- ③ 決済時のドル調達レート変動による影響
- ④ ドル建売掛金入金時のレート変動による影響

為替変動による影響の発生要因①

【仕入値引ドル建債権の為替変動による影響】

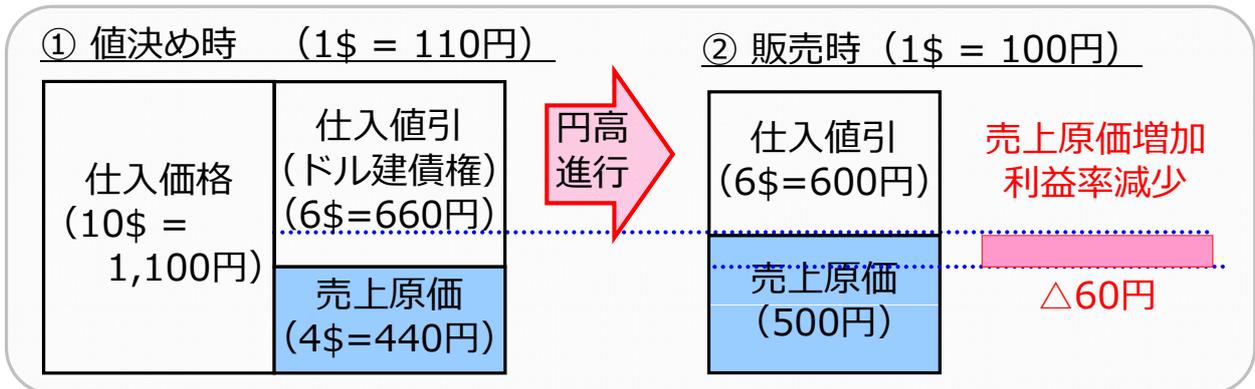
- 当社が仕入先に対して保有する『仕入値引ドル建債権』が、為替レートの変動により評価額が増減することで、業績に大きな影響を与える
- 仕入値引ドル建債権について：
 - ・ 量産案件によっては、通常価格よりも低い価格での販売を要請されることがある
 - ・ その場合、仕入先との間で仕入価格の低減交渉を行う
 - ・ その実現方法は、「仕入値自体の低減」と「仕入値引債権の付与による低減」



急速な円高進行による仕入値引債権の評価額減少

- 仕入値引債権の評価額の増減は、値決め時と販売時の為替レートの差により生じる
- そのため、急速に円高が進行すると、為替レートの差が大きくなるため、仕入値引債権の評価額が大幅に減少
- これにより、売上原価が増加し、売上総利益が減少

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化

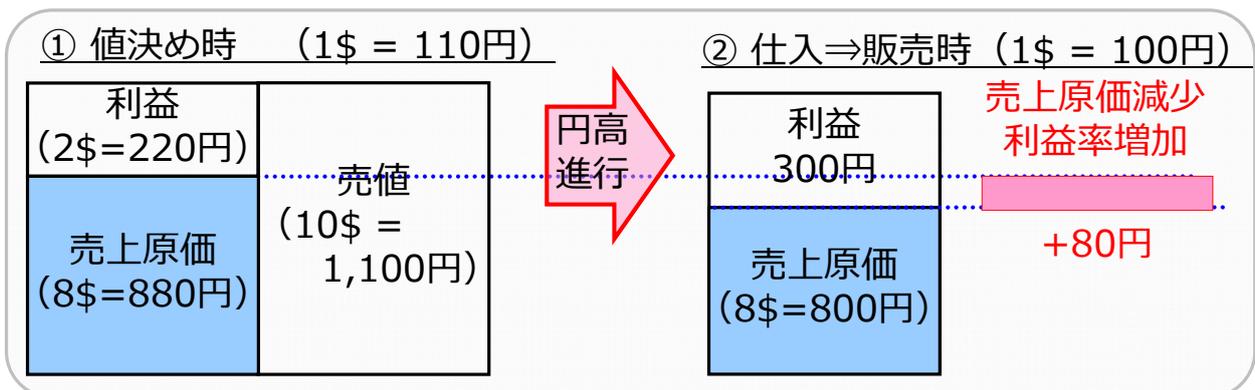


為替変動による影響の発生要因②

【調達在庫の為替変動による影響】

- 海外から仕入れたドル建の製品において、為替レートが円高に進行することにより、売上原価が減少し、売上総利益は増加

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化

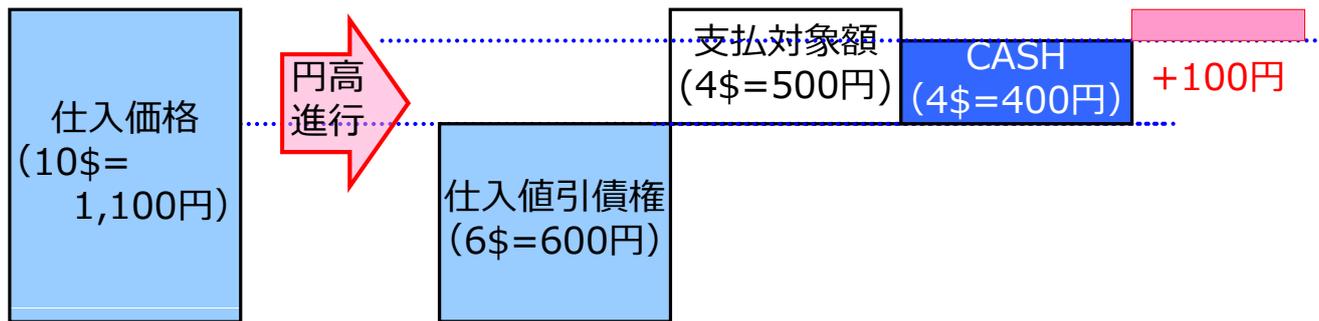


為替変動による影響の発生要因③

【決済時のドル調達レート変動による影響】

- 支払を行う際に円高に進行していた場合、ドルを調達する金額が少なくなるため、決済差額が生まれ、為替差益を計上することとなる
- 一方、円安に進行した場合は、為替差損を計上することとなる

① 仕入時 (1\$ = 110円) ② 販売・支払時 (1\$ = 100円)



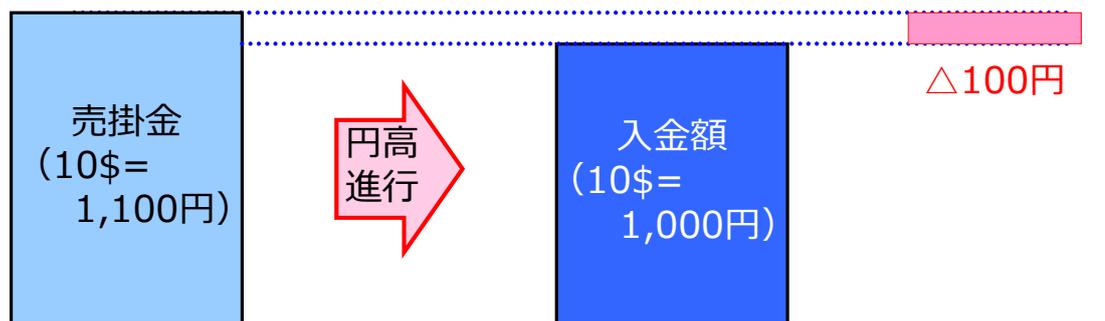
為替変動による影響の発生要因④

【ドル建売掛金入金時のレート変動による影響】

- ドル建売掛金の入金がある場合には、円高に進行するとマイナス、円安に進行するとプラスの影響が発生する（営業外の為替差損益）
- 当社はこのリスクを限定的にするために、為替予約を行っている

① 販売時 (1\$ = 110円)

② 入金時 (1\$ = 100円)



■ 売上総利益への影響額

- 為替レートが円高に進行したことにより、年間ではマイナス方向に

(単位：百万円)	17Q1	17Q2	17Q3	17Q4	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4
為替レートの変動（円）	117→ (110)→ 111	111→ (108- 114)→ 112	112→ (114- 107)→ 112	112→ (114- 110)→ 112	113→ 106	106→ (111)→ 109	111→ 113	113→ 110
為替変動の影響（売上総利益）	102	-52	-83	56	-148	3	52	59
仕入値引債権の評価額変動の影響	128	-156	-62	109	-338	-8	307	341
調達在庫の為替レート変動の影響	-26	104	-21	-53	189	11	-256	-280

■ 営業外損益への影響額（期末評価替の影響は含まず）

- 買掛金支払時のレート変動の影響は、売上総利益への影響と、おおよそ相殺関係となる

(単位：百万円)	17Q1	17Q2	17Q3	17Q4	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4
買掛金支払時のレート変動の影響（営業外）	36	46	54	-24	88	-19	-89	-34

- 売掛金受取時のレート変動の影響額は、為替レートが円高に進行したことによりマイナス方向に（為替予約実施のため変動影響は縮小されている）

(単位：百万円)	17Q1	17Q2	17Q3	17Q4	18Q1	18Q2	18Q3	18Q4
売掛金受取時のレート変動の影響（営業外）	25	-29	-34	12	-74	-25	-8	20

(百万円)	2018年12月期 実績			2019年12月期 業績予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
半導体	14,681	13,855	28,536	11,700	13,600	25,300	△3,236	△11.3%
FPGA	6,025	5,944	11,969	5,200	5,800	11,000	△969	△8.1%
特定用途IC	2,109	2,262	4,372	1,600	1,600	3,200	△1,172	△26.8%
汎用IC	1,871	1,842	3,713	1,700	2,000	3,700	△13	△0.4%
アナログ	1,133	1,237	2,371	800	1,300	2,100	△271	△11.4%
メモリ	3,541	2,568	6,110	2,400	2,900	5,300	△810	△13.3%
デザインサービス	814	985	1,799	900	1,100	2,000	200	11.1%
ソリューション	89	144	233	400	300	700	466	199.8%
売上高合計	15,585	14,984	30,569	13,000	15,000	28,000	△3,236	△11.3%
営業利益	381	176	558	30	270	300	△2,569	△8.4%

開示区分	内容説明
半導体事業	半導体及び関連製品の販売、技術支援
FPGA	ザイリンクス社のFPGAやSoCなどを中心とするソリューション
特定用途IC	特定用途に特化した半導体を中心とするソリューション (例：通信向け、インタフェース向け、携帯端末向け等)
汎用IC	NXPセミコンダクターズ社、マイクロチップテクノロジー社等の汎用ICを中心とするソリューション
アナログ	アナログ半導体を中心とするソリューション
メモリ	マイクロンテクノロジー社等のメモリを中心とするソリューション
デザインサービス事業	受託開発、ODM/EMS/OEM
ソリューション事業	最終製品レベルでのソリューション提案を実施 自社製品（ハードウェア、ソフトウェア、システム）の 開発・販売

以下の担当までお問い合わせ下さい。

株式会社PALTEK

柴崎 由記 (IR担当)

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル

TEL : 045-477-2072

FAX : 045-477-2012

E-mail : ir@paltek.co.jp